Pâte à souder T6204-GM155-GQ COSMO

GENMA EUROPE

Description du produit

Pâte à souder GENMA – notre pâte à souder avec plomb T6204-GM-155-GQ convainc par son excellente imprimabilité, même en impression continue. L'impression a des contours nets, la pâte à souder a une adhérence constante lors de l'assemblage. La viscosité stable permet un stockage jusqu'à 12 mois, ce qui simplifie la disposition pour vous. Même sur des surfaces difficiles, un très bon mouillage garantit des points de soudure parfaits - également sur les BGA. La large plage de fusion de cet alliage contrecarre l'effet pierre tombale. Les assemblages brasés ont peu de retassures. Il n'est pas nécessaire de nettoyer après le soudage. La pâte à souder peut être soudée sous air ou sous gaz inerte.

Propriétés techniques

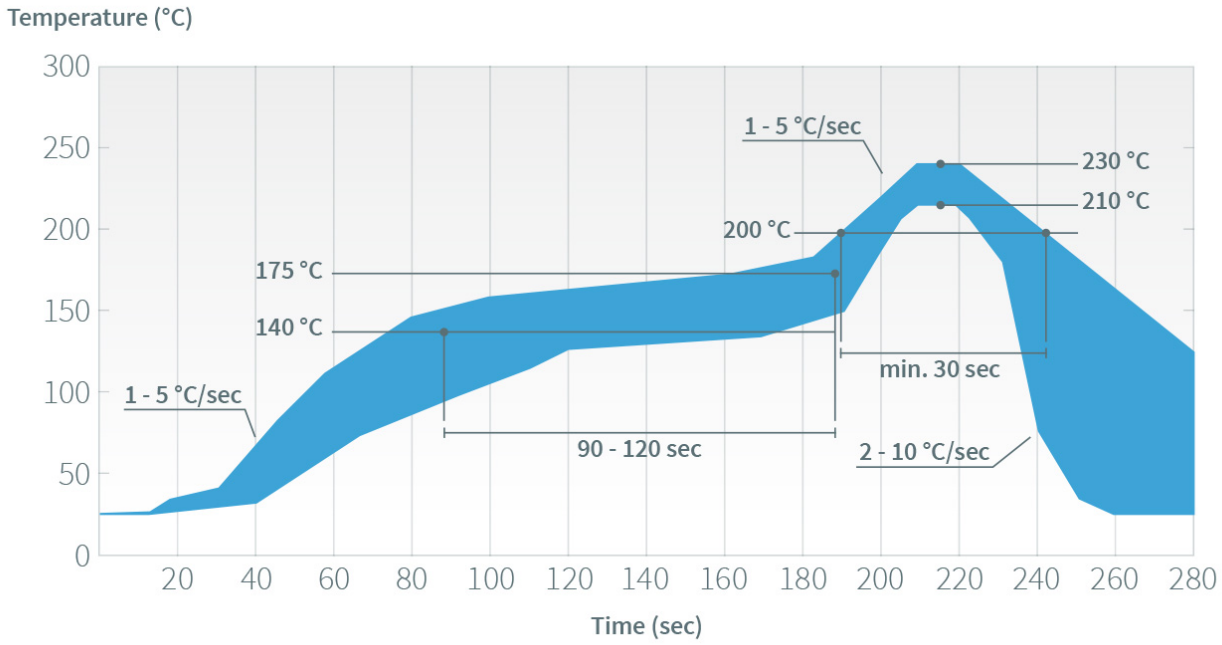
	Valeur spécifique	Méthode d'essai
Alliage (wt %)	Sn 62 / Pb 37,6 / Ag 0,4	
Plage de fusion (°C)	179 - 190	IEC61189-11
Taille de la poudre (µm)	22 - 38, type 4	IPC-TM-650-2.2.14.2
Viscosité (Pas)	190 ± 20	IPC-TM-650-2.4.34.3
Teneur en flux (%)	9,5 ± 0,3	IPC-TM-650-2.3.34.1
Type de flux	ROL0, no clean	IPC-J-STD-004B
Grille d'application (mm)	0,4	
Teneur en halogène (%)	0,035 ± 0,015	IPC-TM-650-2.3.35
Fonctionnement à l'impression (mm)	0,2	IPC-TM-650-2.4.35
Fonctionnement à l'impression (mm)	0,2 - 0,3	IPC-TM-650-2.4.35 (150°C / 60sec)
Résistance d'isolation (Ω)	> 1 x 10^{12} (40°C 90 % humidité relative)	IPC-TM-650-2.6.3.3
Résistance d'isolation (Ω)	> 5 x 10^{8} (85°C 85 % humidité relative)	IPC-TM-650-2.6.3.3
Test de migration	Pas de migration	IPC-TM-650-2.6.14.1
Test de niveau de cuivre	Pas de corrosion	IPC-TM-650-2.3.32
Unité d'emballage	Dose (0,5 kg) Semco Kartusche (0,65 kg, 1,2 kg)	
Durée de conservation minimum	12 mois à 0 - 10 °C, 3 mois < 35 °C	
Transport	Possible sans refroidissement	
Trempe de la pâte à souder	Amener à température ambiante à temps avant ouverture pour éviter la condensation.	
Température recommandée lors de l'impression (°C)	20 - 80	
Température recommandée lors de l'impression (°C)	25 ± 3	
Humidité relative recommandée en % à l'impression	50 ± 20	

GENMA Europe GmbH | Robert-Bosch-Str. 18 | 71394 Kernen i. R. Germany | Phone +49 7151 206610 | team@genma.eu | www.genma.eu

Conformité

À l'exception du plomb, la pâte ne contient aucune substance supérieure à la valeur limite (0,1 %) conformément au règlement REACH CE no 1907/2006 (liste SVHC version 13.11.2025)

Profil de flux recommandé



Préchauffage

L'élévation de la température jusqu'à la zone de préchauffage devrait être de 1 – 5 °C/seconde. Un accroissement trop rapide de la température peut conduire à une dispersion de la pâte à souder.

Dans un but d'atteindre une dissémination aussi réduite que possible de la température (⊿t) sur la plaquette de circuit imprimé, la température dans la zone de préchauffage devrait être de 160 – 175 °C et la durée de préchauffage de 90 à 120 secondes. En cas de température inférieure et de durée plus réduite, la dissémination de la température (⊿t) sur la plaquette de circuit imprimé est trop importante. En cas de température supérieure et de durée plus importante, les activateurs sont perdus, ce qui peut conduire à ce que la pâte à souder ne fonde pas.

Pic de reflux

Nous recommandons de maintenir la température au-dessus de 200 ° C pendant 30 secondes si possible. Des températures de 210 à 230 ° C doivent être atteintes au maximum.

Refroidissement

La vitesse de refroidissement devrait se trouver entre 2 – 10°C/seconde. Un refroidissement trop lent peut conduire à un glissement ou un redressement des éléments de construction et réduire l'épaisseur de la connexion soudée. Un refroidissement au contraire trop rapide peut endommager les éléments de construction par un choc thermique.

GENMA Europe GmbH | Robert-Bosch-Str. 18 | 71394 Kernen i. R. Germany | Phone +49 7151 206610 | team@genma.eu | www.genma.eu